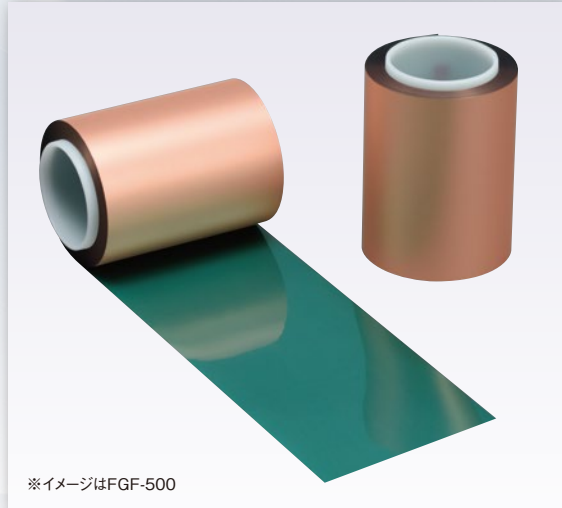


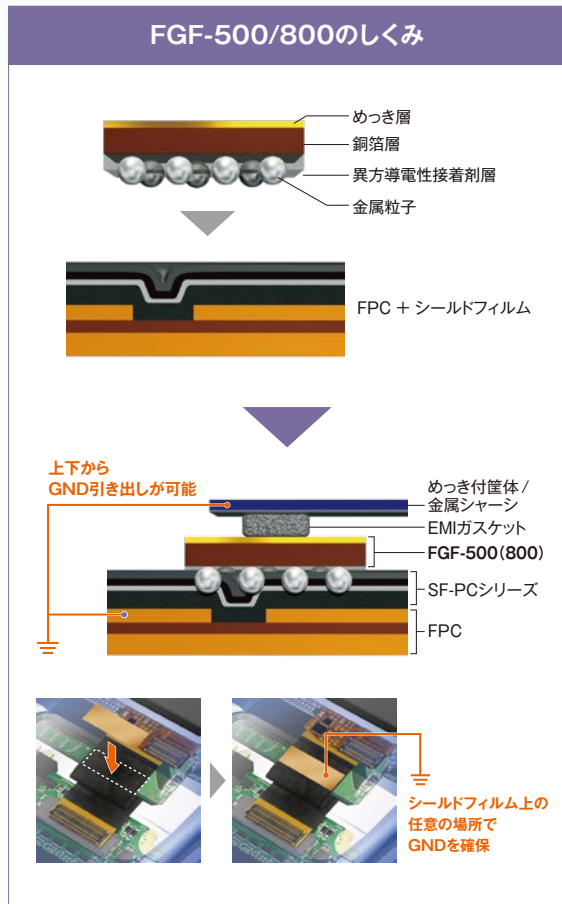
# GND引き出しフィルム



※イメージはFGF-500

## UL登録内容

UL94 V-0 (Kapton50Hとの組み合わせ)  
 ※Kapton®は米国デュポン社の登録商標です



※イメージはFGF-500

## FGF®-500/800

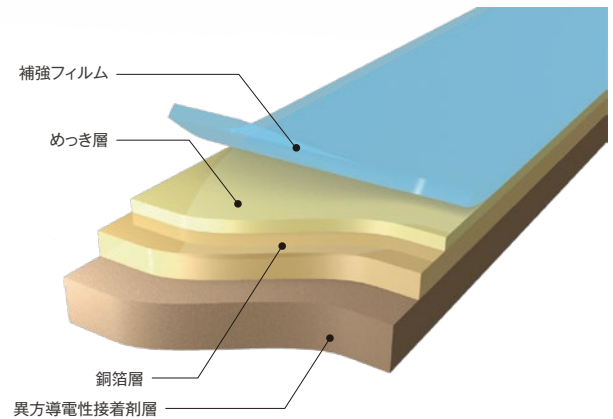
### シールドフィルム上の任意の場所でGND確保が可能

異方導電性接着剤に含まれる導電粒子がシールドフィルムのシールド層とコンタクトし、FPCのGNDを外部に引き出すことができます。また最外層はAuめっき処理により、安定した接続抵抗を実現しています。

※TATSUTA製シールドフィルム以外との使用は一切保証しておりません

## 特徴

- ▶ GND接続部の部分多層化が可能  
シールドフィルム上の任意の場所からGNDを引き出せる
- ▶ 基板の高密度配線化が可能  
FPC配線エリア内に外部接続用のGNDを確保できる
- ▶ 総厚12μmの超薄型を実現 (FGF-500)  
FPC本来の可撓性を維持できる
- ▶ 小面積にも対応 (FGF-800)  
小面積での安定した接続抵抗値を実現



代表スペック	FGF-500/FGF-800
補強フィルム厚み	64μm(青色)
製品総厚み(プレス後)	12μm (FGF-500) 16μm (FGF-800)
めっき層厚み	約0.5μm 最外層はAuめっき
銅箔層厚み	6μm
異方導電性接着剤層厚み	6μm (FGF-500) 10μm (FGF-800)
接続抵抗	300mΩ
接着強度	3.0N/cm以上
製品ライフ(冷蔵)	6ヶ月